

國立交通大學

材料科學與工程研究所

碩士論文

覆晶封裝鉚錫技術中

熱時效對電遷移效應的影響

**Effect of Aging on Electromigration
of Flip-Chip Solder Joints**



指導教授：陳 智 博士

研究生：張哲誠

學號：9318519

中華民國九十五年七月

覆晶封裝鉛錫技術中熱時效對電遷移效應的影響

Effect of Aging on Electromigration of Flip-Chip Solder Joints

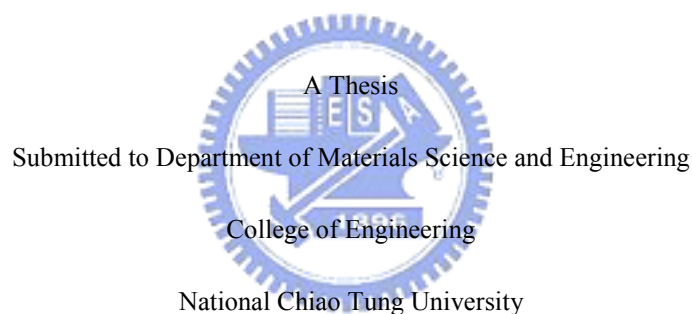
指導教授：陳 智 博士 Advisor : Dr. Chen Chih

研究生：張哲誠 Student : Che-Cheng Chang

國立交通大學

材料科學與工程學系所

碩士論文



in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Materials Science and Engineering

July 2006

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十五年七月